



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

MCA

电话: +1-650-968-8900, 分机 125

电邮: dmoreno@mcapr.com

**在 EUV 光刻技术和多电子束光罩刻写技术成为 2017 年主题之际，中芯国际 (SMIC) 加盟
EBEAM INITIATIVE**

圣荷西，加州，美国，二零一七年二月二十八日—The eBeam Initiative，一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体，今天宣布，中芯国际积体电路制造（上海）有限公司 (SMIC) —世界顶级晶圆代工厂商之一，正式加盟 eBeam Initiative。这个半导体技术的权威机构将其独特视角和领导力，带入已有超过 45 家涵盖半导体光罩和光刻的整个供应链成员组成的 eBeam Initiative 大家庭中。于此相关，the eBeam Initiative 今天同时宣布其 2017 年教育努力的重点将聚焦在电子束技术的需求和发展，以支持 EUV 微影和多电子束光罩刻写技术。The eBeam Initiative 将邀请业界专家对上述提及的项目在 eBeam Initiative 整年的活动中进行深入探讨；就在今天，SPIE Advanced Lithography Conference 会议期间，在圣荷西会议中心举办的会员和媒体午餐会开启今年这些活动的序幕。

“中芯国际在两年前 eBeam Initiative 年度光罩制造商调查开始就是积极的参与者，”中芯国际光罩厂资深总监郭贵琦(Eric Guo)表示，“作为 eBeam Initiative 新成员，我们期望继续支持 eBeam Initiative 类似年度光罩制造商调查等计划，不但对我们自身有所帮助，更惠及整体光罩界。”

去年, The eBeam Initiative 所做的第五界年度会员感知调查中，涵盖半导体光刻和光罩整个供应链的 73 位业界专家参加了调查。调查结果显示，对 EUV 微影的负面印象是调查开始以来的最低的；而对其乐观的印象，则保持稳定；相较其他光刻技术 (NGL)，对 EUV 的信心有所增加。同时，对多电子束光罩刻写的认知，则格外引人注目；期待光罩会在 2018 年底大量使用多电子束光罩刻写机于制造端。这种期望反应出对多电子束技术的持续增加的认可—不管在半导体制程中应用哪种微影技术，光罩复杂程度的增加及对电子刻写精度的需求都形成对多电子束技术需求的增長。The eBeam Initiative 会员调查结果清晰地显示围绕 EUV 微影和多电子束刻写课

题电子束新发展的兴趣和方向，the eBeam Initiative 将增加其在教育推广上的努力，聚焦在这两项重要技术领域上。

“对 the eBeam Initiative 来讲，这实在是令人激动的时刻，” D2S 执行长藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主办管理公司。“我们不但见证将 EUV 微影用于制造持续的进展和信心的增长，还有光学微影技术持续突破其可能想到的物理极限—通过多重微影技术成像 (Multi-patterning Technique)，逆向光刻技术 (ILT-Inverse Lithography Technique)，高阶复杂图形光罩，以及多电子束光罩刻写。所有这些进展都和电子束技术的创新紧密相关，也因此，类似于 the eBeam Initiative 的努力，对业界通力合作的需求也被凸显出来。对此，我们非常高兴的欢迎中芯国际 (SMIC) 成为我们新的会员。对于我们正在进行的工作—提高光罩界和半导体界对电子束技术重要性的认知，它带来其独特的观点和看法。”

一年一度的 eBeam Initiative 会员和媒体午餐会将于今天举行。会上将有业界专家专题讲座。题目包括：电子技术在快速 EPE (Edge Placement Error-边界定位误差) 测量中的进展；多电子束光罩刻写光罩模型，和 ILT 的再次崛起。讲座内容将会在二月二十八日后发表于 eBeam Initiative 网站上 www.ebeam.org。

“这个会议 (SPIE Advanced Lithography Conference) 之后的一年中，the eBeam Initiative 还将在其它业界论坛继续其在 EUV 微影技术和多电子束光罩刻写领域电子束新进展的教育与宣传的努力。”藤村又表示，“随后的几个月，我们会在三月举行的中国国际半导体技术年会 (CSTIC) 和四月举行的日本光罩年会 (PMJ) 上再次强调这些议题的重要性；并且在四月的日本光罩年会 (PMJ) 上，会有 GPU 加速在光罩技术上应用的特殊章节介绍。”

关于 The eBeam Initiative (电子束倡议团)

The eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。The eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。

会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括：aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenlSys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KLA-Tencor; Maglen; Mentor Graphics Corporation; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai)

**SMIC JOINS THE EBEAM INITIATIVE AS EUV LITHOGRAPHY AND MULTI-BEAM MASK WRITING
BECOME KEY THEMES FOR 2017.....PAGE 3 OF 3**

Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; TOOL Corporation;
Toppan Printing; Toshiba; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS.
The eBeam Initiative 欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###